

COB陶瓷基板的封装方式

产品名称	COB陶瓷基板的封装方式
公司名称	富力天晟科技（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋1单元1层01室383号
联系电话	027-88111056 15527846441

产品详情

随着LED照明应用的成熟，大功率LED需求发烫，LED封装厂近年来积极导入适用于高功率的COB支架，但也有业者指出，COB支架制程与过去PPA支架差异较大，从设备建置的角度来看，业者朝EMC支架的意愿较高，据悉，采用EMC支架的LED目前已over-drive至3W，并正朝向5W前进。

富力天晟科技（武汉）有限公司，是一家从事平面、三维无机非金属基电子线路和电子元器件研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司目前已经量产的产品是氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板，采用激光快速活化金属化技术（Laser Activation Metallization,简称LAM技术），金属层与陶瓷之间结合强度高，导电性好，可以多次焊接，金属层厚度在1 μm-1mm内可调，L/S分辨率*大可以达到10 μm，可以方便地直接实现过孔连接。

陶瓷电路板技术参数：

可焊性：可在260 多次焊接，并可在 - 20 ~ 80 内长期使用

高频损耗：小，可进行高频电路的设计和组装

线/间距（L/S）分辨率：*大可达20 μm

有机成分：不含有机成分，耐宇宙射线

氧化层：不含氧化层，可以在还原性气氛中长期使用

陶瓷电路板售后服务：

感谢您选购本公司陶瓷电路板，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。